

熱處理硬化層深度測量裝置

Hardness EYE

以 X 光回折之半高寬測量
淬火處理後鋼材之硬化層深度

不需將測量面做鏡面研磨
可自動測量

- ◆ 填充樹脂、鏡面研磨等前置作業之**工程縮減**
- ◆ 測量所花費之**時間縮減**
- ◆ 研磨劑及樹脂等**消耗品之縮減**
- ◆ 「硬度」、「深度」可**自動判定** OK/NG



特性

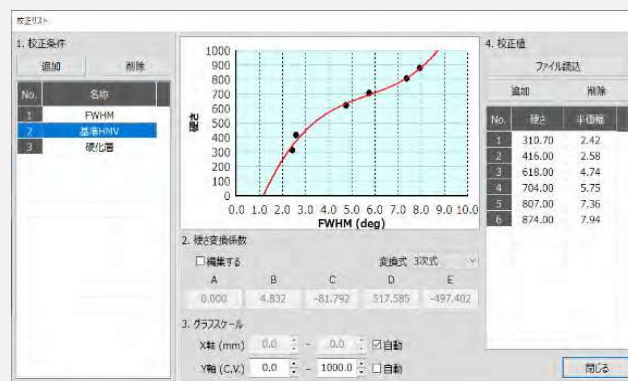
一. 將切斷面向下，設置簡易



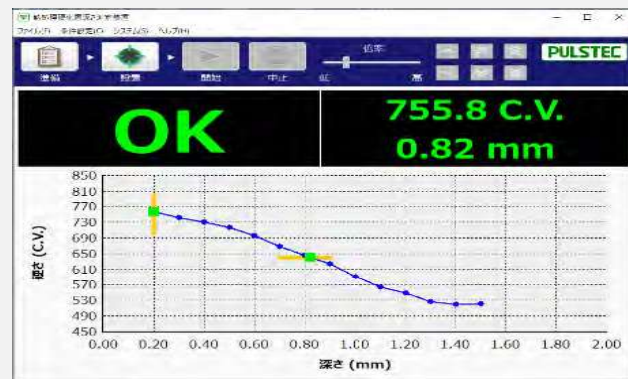
二. 以顯微鏡畫面正確調整測量開始位置



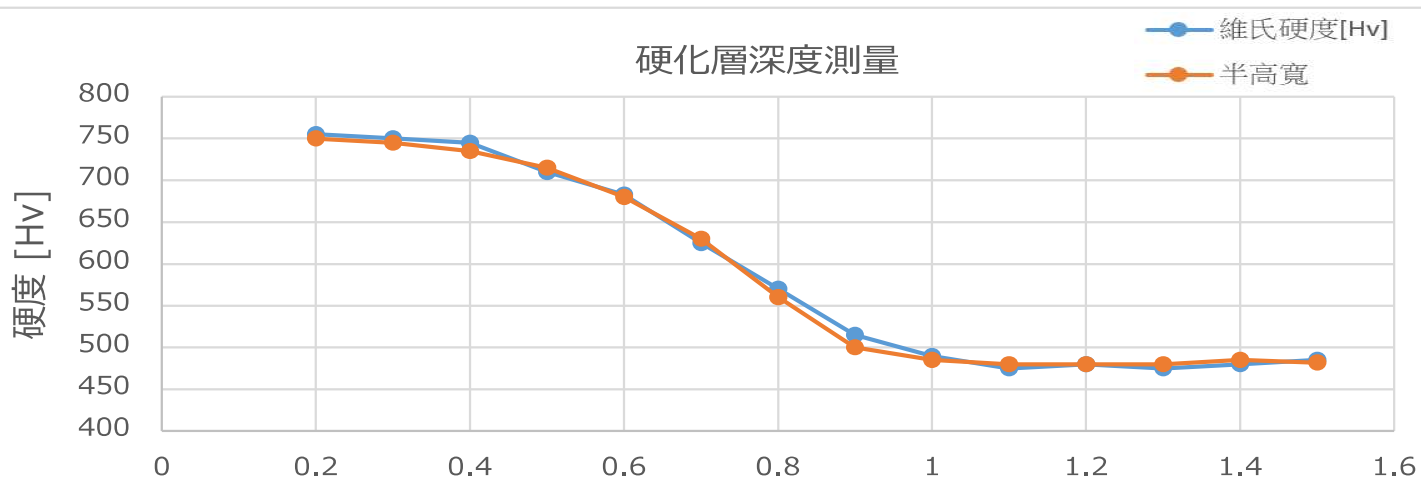
三. 已知的硬度值與半高寬依鋼種類校正



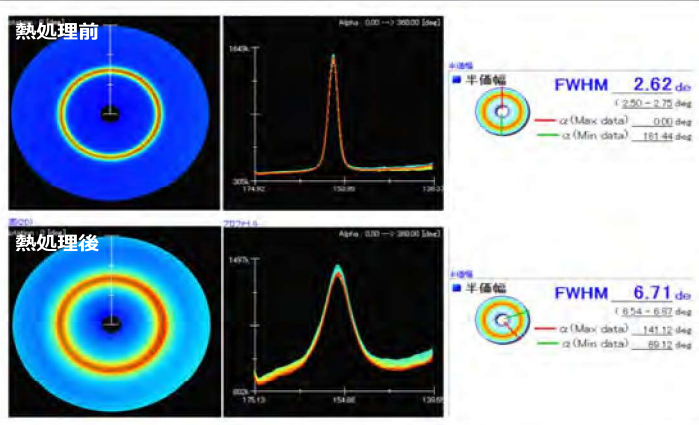
四. 測量結果以圖表輸出並顯示判定結果



硬化層深度曲線 (X 光半高寬 vs 微小維克氏硬度)

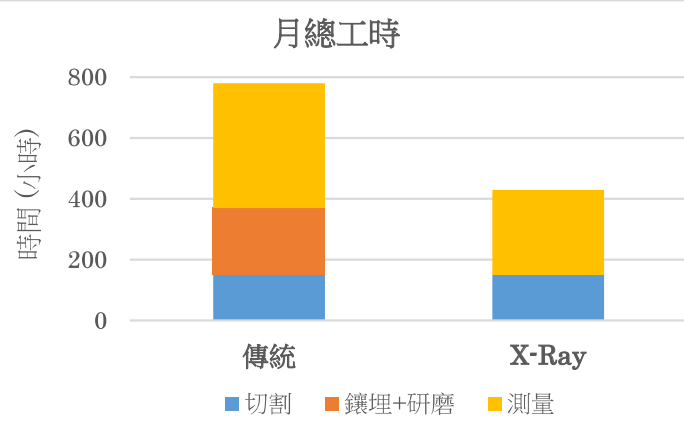


熱處理前後回折環與半高寬之差異



熱處理後硬度上昇。
回折環 Profile 變寬、
半高寬也增加了 (2.62deg→6.71deg)。

以 X 光檢測可減縮之工時



由於不需填充樹脂、亦不需鏡面研磨工程
一個月工時可減少約 1/2
亦即 780 小時→減少為 430 小時。

規格

X 光管球種類、電壓／電流	Cr、30kV／1.5mA
X 光冷卻機構	空冷
對象物	滲碳淬火品、高周波淬火品
Line 測量範圍	0.2~10mm、自動走查
測量結果	將硬度推移曲線、有效硬化層深度、 做 OK/NG 判定 (以指定「硬度」/「深度」來判定)
外形尺寸、重量	W280mm×D600mm×H390mm、約 28 kg (不含控制 PC)
電源	100~240V

注意:有關於X-Ray裝置的操作 操作該X-Ray裝置，必須要取得[放射性物質或可發生游離輻射設備]輻安證書18小時以上的人員